

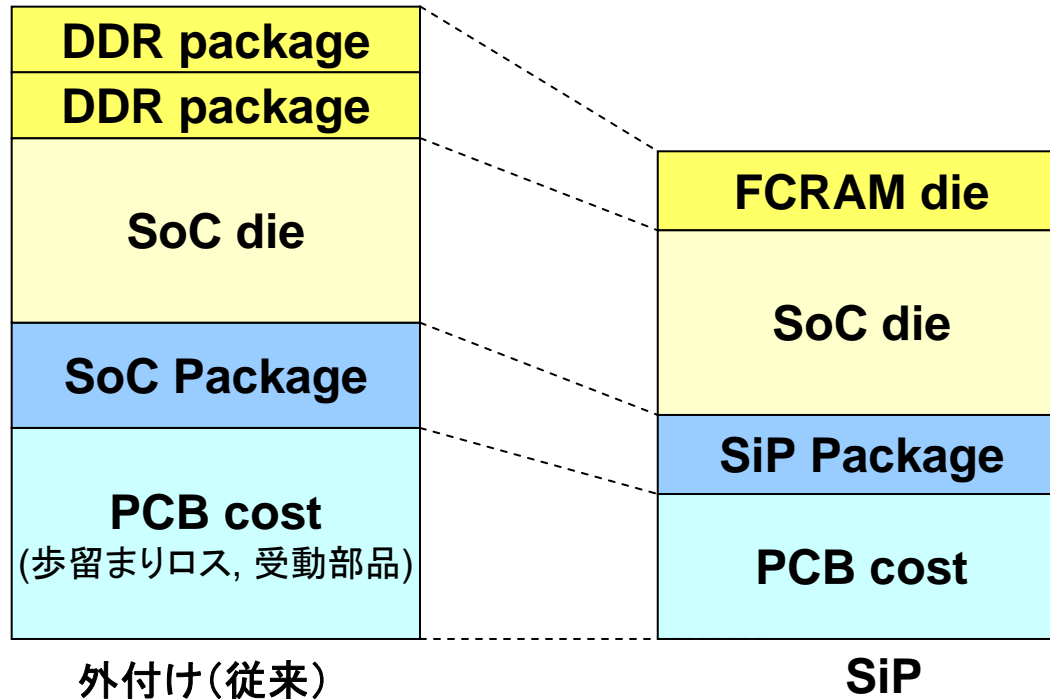
メモリシステムのコスト比較

■ システムコストが重要になってきている

■ メモリシステムの周波数が上がると、パッケージやPCBコストが上昇

- 電源ピン数の増加(それに伴うパッケージの大型化)、フリップチップ化
- PCB層数の増加、受動部品コストの上昇

■ SiPによりパッケージやPCBコストを最小化



● [SiP \(System in Package\)ソリューションの詳細については、こちらをクリック願います!](#)

※ 使用するチップの組み合わせ、パッケージ、システム構成によって、コストイメージは変動します。